

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2024-020

成都新易盛通信技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 709,919,026 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 4,200 股后的股本 709,914,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新易盛	股票代码	300502
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王诚	魏玮	
办公地址	四川省成都市双流区黄甲街道物联大道 510 号	四川省成都市双流区黄甲街道物联大道 510 号	
传真	028-67087979	028-67087979	
电话	028-67087999-8288	028-67087999-8288	
电子信箱	daniel.wang@eoptolink.com	vivi.wei@eoptolink.com	

2、报告期主要业务或产品简介









（一）主营业务、主要产品及用途








目前，公司业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，公司一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售，产品服务于 AI/ML 集群、云数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输、固网接入等领域的国内外客户。

公司自成立以来一直专注技术创新，从而推动光模块向更高速率、更小型封装、更低功耗、更低成本的方向发展。为云数据中心客户提供 100G、200G、400G、800G 及 1.6T 光模块产品；为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块、以及应用于城域网、骨干网和核心网传输的光模块解决方案。经过十多年的发展，已在本行业客户中拥有较高的品牌优势和影响力。

主要产品及功能运用如下：

产品系列	产品照片	产品简介	主要应用场景
OSFP-XD 1.6T		OSFP-XD 1.6T 光模块符合 OSFP-XD MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 5.0 和更新版本；涵盖 DR8, 2xFR4 and 4xFR2 传输接口。	数据中心、1.6T 以太网、云计算网络等
QSFP-DD 800G 单波 200G		OSFP-DD 800G 单波 200G 光模块符合 QSFP-DD800 MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 5.0 和更新版本；涵盖 DR4+、1xDR4、1xFR4 和 2xFR2 传输接口。	数据中心、800G 以太网、云计算网络等
OSFP 800G 单波 200G		OSFP 800G 单波 200G 光模块符合最新版本的 OSFP MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 5.0 和更新版本；涵盖 DR4+、1xDR4、1xFR4 和 2xFR2 传输接口。	数据中心、800G 以太网、云计算网络等
QSFP-DD 800G 单波 100G		OSFP-DD 800G 单波 100G 光模块符合 QSFP-DD800 MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 4.0 和更新版本；涵盖 SR4.2、SR8、DR8、2xFR4 和 2xLR4 传输接口，新推出 800G BIDI、800G LPO 和 800G 低功耗产品。	数据中心、800G 以太网、云计算网络等
OSFP 800G 单波 100G		OSFP 800G 单波 100G 光模块符合最新版本的 OSFP MSA 的最新版本；固件支持 CMIS 4.0 和更新的版本；涵盖 SR8、DR8、2xFR4 和 2xLR4 传输接口，新推出 800G LPO 和 800G 低功耗产品。	数据中心、800G 以太网、云计算网络等
800G/400G 相干系列模块		800G/400G 相干系列光模块符合 MSA 及 OIF 最新要求，固件支持 CMIS 4.0 或更新版本。支持高达 120km 或者 500km 的长距离业务传输。	以太网，数据中心互联等。
QSFP112 400G		QSFP112 400G 系列光模块符合 QSFP112 MSA 的最新要求，固件支持 CMIS 4.0 或更新版本，支持 SR4、DR4、FR4 和 LR4 传输接口，可满足超低功耗要求。	数据中心、400G 以太网、云计算网络等
QSFP-DD 400G		QSFP-DD 400G 系列光模块符合 QSFP-DD MSA 的最新要求，固件支持 CMIS 4.0 或更新版本，支持 SR8、SR4、SR4.2、DR4、FR4 和 LR4 传输接口，可满足超低功耗要求。	数据中心、400G 以太网、云计算网络等

OSFP 400G		<p>OSFP 400G 系列光模块符合 OSFP MSA 的最新要求，固件支持 CMIS 4.0 或更新版本，支持 SR8、SR4、SR4.2、DR4、FR4 和 LR4 传输接口，可满足超低功耗要求。</p>	<p>数据中心、400G 以太网、云计算网络等</p>
QSFP-DD 200G		<p>QSFP28-DD 200G 系列光模块符合 QSFP-DD MSA 的最新要求，固件支持 CMIS 4.0 或更新版本，支持 2x100G SR4 CWDM4 和 LR4 传输接口，可满足超低功耗要求。</p>	<p>数据中心、200G 以太网、云计算网络等</p>
QSFP56 PAM4 200G		<p>QSFP56 PAM4 200G 系列光模块符合 QSFP56 MSA 的最新要求，固件支持 CMIS 4.0 或更新版本，支持 SR4、FR4 和 LR4 传输接口使用 4x50G 的 PAM4 通道来实现 200G 传输，电接口支持 200GAUI-4 应用。</p>	<p>数据中心、200G 以太网、云计算网络等</p>
CFP2 PAM4 200G		<p>CFP2 PAM4 200G LR/ER 系列光模块符合 CFP2 MSA 的最新要求，可支持 212.5Gbps10km/40km 数据传输应用，可通过 MDIO 接口实现数字诊断功能。</p>	<p>200G 以太网、5G 回传光网络等。</p>
QSFP28 Single Lambda		<p>单通道 100G QSFP28 系列光模块符合 QSFP28 MSA 的最新要求，支持 DR、FR、LR、ER 传输接口，可选支持 CWDM 和 DWDM 波长，涵盖单纤和双纤两类应用场景。</p>	<p>数据中心、100G 以太网、5G 中传和回传网络等</p>
QSFP28/QSFP+		<p>QSFP28/QSFP+系列满足 QSFP28/QSFP+ MSA 的最新要求，可支持 100G/40G SR4、LR4、ER4、ZR4，以及 CWDM4、4WDM4-10、4WDM-20 和 4WDM-40 等传输接口。</p>	<p>数据中心、100G 以太网、电信数通网络</p>
CFPx 系列		<p>CFP/CFP2/CFP4 系列模块分别符合 CFP/CFP2/CFP4 MSA 要求，支持 OTU4 4I1-9D1F/4L1-9C1F 以及 100GBASE-LR4/ER4 应用。</p>	<p>100G OTN 以及以太网骨干核心传输网应用。</p>
QSFP28 PAM4 50G		<p>50G PAM4 QSFP28 LR/ER 光模块符合 QSFP28 MSA 要求，支持 10km、40km 传输应用，可支持单纤和双纤两种光纤接口形式。</p>	<p>50G 以太网 5G 中传网络应用。</p>

SFP112 PAM4 100G		SFP112 PAM4 100G 系列光模块符合 SFP112 MSA 以及 IEEE 最新要求, 涵盖商用和工业级温度范围, 支持 500m, 2km, 10km, 40km 传输应用。	数据中心、100G 以太网、5G 中传和回传网络等
SFP-DD PAM4 100G		SFP-DD PAM4 100G 系列光模块符合 SFP-DD MSA 和 100GAUI-2, 支持 500m, 2km, 10km, 30km, 40km 传输应用。	数据中心、100G 以太网、5G 中传和回传网络等
SFP56 PAM4 50G		50G PAM4 SFP56 SR、LR、ER 光模块满足 MSA 以及 IEEE 标准要求, 支持 100m, 10km, 40km 传输应用, 可支持单纤和双纤两种光纤接口形式。	数据中心、50G 以太网、5G 前传和中传网络等应用。
SFP28 系列		SFP28 系列光模块满足 SFP28 MSA 要求, 涵盖商用和工业级温度范围, 可支持单纤和双纤传输方式 LC 接口, 涵盖单纤和双纤两类应用场景。	5G 前传、25G 以太网、32G 光纤通道等
XFP 系列模块		XFP 是一种支持万兆应用的光模块, 支持 SC 和 LC 两种接口, 涵盖单纤和双纤两类应用场景。	SDH/SONET 电信网、以太网、光纤通道、智能电网、视频监控网等;
SFP+/SFP 系列模块		SFP+/SFP 系列是小型可插拔模块, 支持 SC 和 LC 两种接口, 涵盖单纤和双纤两类应用场景。	SDH/SONET 电信网、以太网、光纤通道、智能电网、视频监控网等;
PON 系列		涵盖 XFP、SFP+、SFP、SFF、SFP28、SFP-DD、QSFP-DD 等封装结构, 可支持非对称或对称网络传输方式, 支持 SC、LC 和尾纤式接口, 涵盖 1G, 10G PON 及更高速率的 PON 应用场景	PON、FTTx 网络等。

(二) 公司经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为光器件 (CHIP、TO-CAN、BOSA、ROSA、TOSA)、集成电路芯片、结构件和 PCB。

主要原材料的采购情况

A. 光器件

光器件主要包括 CHIP、TO-CAN、BOSA、ROSA、TOSA, 光器件的采购方式为:

a. 直接采购 ROSA、TOSA;

b. 采购 TO-CAN 或领用自行加工的 TO-CAN（采购 CHIP 后加工而成，光器件芯片封装环节）后自行加工成 BOSA、ROSA、TOSA（光器件封装环节）；

B. 集成电路芯片

公司集成电路芯片全部为直接采购。

C. 结构件

公司结构件全部为直接采购。

D. PCB

公司采购 PCB 的方式为采购 PCB 裸板（由公司提供电路原理图设计方案和 PCB 板设计方案）后委托专业贴片厂家加工成 PCB 成品。

2、生产模式

在生产方面，公司主要实行“订单生产”的生产模式。公司利用 ERP 生产管理平台对订单进行管控，通过该系统，所有订单能在各部门间快速流转，所有物料均定量发放生产，有效控制生产过程中物料的浪费，从而有效控制生产成本。

3、销售模式

（1）销售模式

公司客户分为通信设备制造商、互联网厂商和经销商。公司对境内客户的销售主要为向通信设备制造商、互联网厂商直接销售；公司对境外客户的销售包括向通信设备制造商、互联网厂商直接销售和经销商销售，其中向经销商的销售全部采用买断式销售。

（2）收入确认方法

1) 国内销售：直销模式下，公司向客户发出商品后，合同约定验收期满如对方没有提出异议，以对方在货运签收单签字后验收期满的时点确认收入；无约定验收期的，以货运签收单签收日的时点确认收入，或以取得对方提供的对账单或电子对账单时确认收入。寄售模式下，公司先将商品发往并存放在客户所属仓库，按照客户领用存货的时点确认收入。与浙江粮油的销售，公司向客户发出商品后，在取得对方提供的货物出口汇总清单时确认收入。

2) 国外销售：FOB 出口形式以出口业务办妥报关出口手续时点确认收入；FCA 形式以货物交给客户或客户指定承运人并办理了清关手续时确认收入；DDP 及 DAP 形式以按照合同规定将货物交由承运人运至约定交货地点，以对方签收的日期时点确认收入；寄售模式下，公司先将商品发往并存放在客户所属仓库，按领用订单约定的时点确认收入。

4、研发模式

公司采取自主研发模式，拥有自主知识产权，具备较强的技术研发能力，目前研发体系团队层次合理，人员精干，具备光通信系统、通信测试系统、自动化测试系统、高速电路系统设计、自动化软件和固件软件开发、高速率光器件芯片封装等领域的理论及实践经验。通过不断加强研发投入，逐步提升公司核心竞争力，保证公司在国内和国际市场竞争中的优势地位。公司积极响应客户的个性化需求，丰富公司的产品类型，同时不断提高光模块产品的性能和稳定性，凭借在高速模数混合电路设计和光模块测试方面的丰富经验，取得了多项专利。公司研发体系将紧跟技术发展和市场的前沿，积极开展对高速及超高速光传输模块的关键技术研究，不断加强项目储备。

（三）公司在产业链位置及市场地位

1、光模块行业产业链

光模块是一种用于高速数据传输的光器件，其作用是实现光信号和电信号之间的相互转换，从而实现数据在通信网络中的传输。光模块的应用场景主要分为两大领域：4G/5G 无线网络、固定宽带 FTTX、传输与数通网络等为代表的电信领域；承载 AR/VR、人工智能、元宇宙等应用的数据中心领域。

光模块产业链：上游包括光芯片和电芯片、光器件/光组件，下游包括通信设备制造商、AI/ML 集群、云数据中心和电信运营商。

2、公司市场地位

公司自成立以来一直专注于光模块的研发、生产和销售，公司是国内少数批量交付运用于数据中心市场的 100G、200G、400G、800G 高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，已成功研发出涵盖 5G 前传、中传、回传的 25G、50G、100G、200G 系列光模块产品并实现批量交付。公司一向重视行业新技术、新产品的研究，目前已成功推出基于

VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的 400G、800G、1.6T 系列高速光模块产品，和 400G 和 800G ZR/ZR+相干光模块产品、以及基于 100G/lane 和 200G/lane 的 400G/800G LPO 光模块产品。经过多年来的潜心发展，公司新产品研发和市场拓展工作持续取得进展，目前已与全球主流互联网厂商及通信设备商建立起了良好的合作关系。

公司致力于围绕主业实施垂直整合，力争抓住良好的市场契机，聚集优势资源持续提升高速率光模块市场占有率，加速硅光、相干光模块、800G/1.6T 光模块等行业前沿领域研究及商用，进一步巩固提升公司在光通信行业领域中的核心竞争优势，努力成为光通信模块、组件和子系统的核心供应商。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	6,439,983,560.34	5,876,061,496.29	5,876,061,496.29	9.60%	4,864,234,763.02	4,864,234,763.02
归属于上市公司股东的净资产	5,465,978,473.54	4,829,167,615.85	4,829,167,615.85	13.19%	3,958,723,671.45	3,958,723,671.45
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	3,097,605,750.52	3,310,573,790.53	3,310,573,790.53	-6.43%	2,908,376,063.76	2,908,376,063.76
归属于上市公司股东的净利润	688,361,095.12	903,581,090.81	903,581,090.81	-23.82%	661,926,139.05	661,926,139.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	677,639,230.06	783,800,736.37	783,800,736.37	-13.54%	597,638,412.97	597,638,412.97
经营活动产生的现金流量净额	1,245,984,809.46	831,352,211.86	831,352,211.86	49.87%	218,531,823.57	218,531,823.57
基本每股收益（元/股）	0.97	1.79	1.27	-23.62%	1.31	0.93
稀释每股收益（元/股）	0.97	1.79	1.27	-23.62%	1.31	0.93
加权平均净资产收益率	13.36%	20.73%	20.73%	-7.37%	17.85%	17.85%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	600,222,891.10	704,460,933.92	782,363,726.80	1,010,558,198.70
归属于上市公司股东的净利润	107,834,813.02	180,530,070.90	141,198,619.60	258,797,591.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,877,359.95	178,087,963.90	140,065,585.00	253,608,321.21

经营活动产生的现金流量净额	254,890,930.77	227,740,476.96	394,452,699.89	368,900,701.84
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,166	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
高光荣	境内自然人	7.39%	52,460,988.00	48,163,957.00	不适用	0.00			
黄晓雷	境内自然人	7.12%	50,567,343.00	37,925,507.00	不适用	0.00			
LO JEFFREY CHIH	境外自然人	3.63%	25,789,548.00	0.00	不适用	0.00			
ROMAN SOKOLOV	境外自然人	2.02%	14,318,896.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	9,717,485.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	8,078,717.00	0.00	不适用	0.00			
中国银行股份有限公司一宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	0.97%	6,892,814.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司	其他	0.76%	5,391,770.00	0.00	不适用	0.00			

限公司 —华安 创业板 50 交易 型开放 式指数 证券投 资基金						
黄声凤	境内自 然人	0.75%	5,358,170.00	0.00	不适用	0.00
中国银 行股份 有限公 司—华 夏行业 景气混 合型证 券投资 基金	其他	0.67%	4,741,428.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系 或一致行动的说明	上述股东中高光荣、黄晓雷为公司一致行动人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
	数量合计	占总股 本的比例	数量 合计	占总股 本的比例	数量合计	占总股 本的比例	数量合计	占总股 本的比例
中国建设银行股份有限 公司—华安创业板 50 交 易型开放式指数证券投 资基金	0	0.00%	0	0.00%	5,391,770	0.87%	165,100	0.02%
中国工商银行股份有限 公司—易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金	0	0.00%	0	0.00%	8,078,717	1.31%	1,209,800	0.17%
#上海呈瑞投资管理有限 公司—呈瑞正乾	11,754,612	2.32%	0	0.00%	3,285,750	0.53%	1,467,700	0.21%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退 出	期末转融通出借股份且尚 未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融 通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	新增	1,209,800	0.17%	8,078,717	1.14%
中国银行股份有限公司—宏利转 型机遇股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	6,892,814	0.97%

中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	新增	165,100	0.02%	5,391,770	0.76%
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,741,428	0.67%
#上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞正乾 65 号私募证券投资基金	退出	1,467,700	0.21%	3,285,750	0.46%
刘冠军	退出	0	0.00%	4,000,029	0.56%
#胡学民	退出	0	0.00%	6,230	0.00%
建信信托有限责任公司—建信信托—金源家族信托单一信托 2 号	退出	0	0.00%	0	0.00%

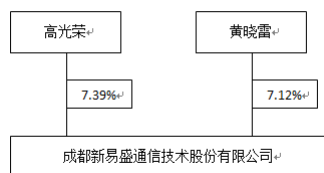
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无